

# 4吨伺服驱动电动洁净室无油150X150Mm热压机 Ce认证

货号: XP69



## 简介

伺服电动驱动精密自动热压机，4吨压力，±2kg精度，无油设计，适用于洁净室环境。150x150mm加热板，独立双区温控，最高可达300°C。CE认证，是半导体、电池研究和材料科学实验室的理想选择。

## 了解更多

应用领域	描述	主要优势
半导体封装	在洁净室中进行芯片贴装、底部填充胶固化和倒装芯片键合，其中无颗粒条件至关重要。150×150 mm加热板可容纳多个芯片载体，可编程的压力曲线确保整个批次的键合线厚度一致。	无油操作防止污染；精确的力和温度控制确保键合完整性和高良率。
电池研究	用于锂离子和下一代电池的电极辊压、固态电解质压制和软包电池封装。施加均匀压力并保持高平整度的能力对于实现目标电极孔隙率和密度至关重要。	均匀的压力分布提高了电极的均质性；双区加热防止对温度敏感的电解质造成热损伤。
材料科学	用于先进材料开发的聚合物热压印、复合材料层压和薄膜制造。研究人员可以优化温度和压力曲线，以研究材料在受控条件下的行为。	可编程升温/保温防止过热；紧凑尺寸可放入层流罩或通风橱，用于危险材料实验。
微流控与MEMS	PDMS与玻璃的热键合、热塑性芯片键合和纳米压印光刻。这些工艺需要极高的力精度，以避免微通道变形或损坏精密的纳米结构。	±2 kg精度保护高深宽比特征；无油设计避免可能改变流体行为的通道污染。
光谱样品制备	用于FTIR的KBr压片、用于XRF的压制片和熔融珠的生产。压力和热量的一致施加确保了均匀的样品基质，减少了光谱散射并提高了分析的可重复性。	可编程的压力和加热循环消除了操作员差异；紧凑尺寸适合放置在光谱仪工作站附近。
先进陶瓷	陶瓷生坯的预压和采用可控加热曲线的粘剂烧除。升温/保温功能允许在最终致密化之前缓慢去除粘剂，最大限度地减少内应力。	斜坡升温减少开裂和翘曲；水冷加速批次间的冷却，提高吞吐量。
薄膜与涂层开发	光伏层的热层压、柔性电子封装和阻隔膜贴附。精确的力可防止涂层损坏，同时确保整个基材的彻底粘合。	精确的压力和平行度避免褶皱和不均匀层压；无油环境保持薄膜的清洁度和附着力。
生物医学设备组装	用于微流控诊断卡盒、导管制造和植入式传感器的生物相容性聚合物的精密键合。无油环境消除了可能浸出到医疗组件中的毒素。	严格的力和温度控制确保清洁、牢固的键合，且材料不降解；适用于经过验证的医疗原型开发实验室。

参数	规格
型号	XP69
压力范围	0 – 4 吨 (约 0 – 40 kN)
压力精度	± 2 kg
驱动系统	伺服电机驱动 (100% 电动, 无油)
加热板尺寸	150 × 150 mm
板间距	50 mm
工作温度	0 – 300°C
温度控制	双板独立PID, 带可编程升温/保温

参数	规格
加热功率	1500 W (1.5 kW)
冷却方式	循环水冷却 (需要外部冷却器/水源)
控制器	7英寸彩色触摸屏, 带实时曲线显示
电源	单相交流 230V, 50 Hz
合规性	CE认证 ; HS编码 8474802000